**Samtec presenta sus diseños de referencia Analog over ArrayTM**

**Los nuevos diseños de referencia son capaces de transmitir señales digitales, analógicas y de alimentación de alta velocidad a través de una sola matriz de conectores.**

[**New Albany, Indiana- EE.UU.**]-- Samtec, Inc., el líder del mercado de conectores, ha introducido mejoras en sus matrices con patillas en disposición abierta para la transmisión simultánea de señales analógicas, digitales y de alimentación. Los nuevos diseños de referencia permiten que las conocidas matrices de conectores de alto rendimiento de Samtec, como [SEARAY](https://www.samtec.com/connectors/high-speed-board-to-board/high-density-arrays/searay)TM, admitan señales analógicas.

Los nuevos diseños de referencia Analog over Array para aplicaciones de RF de alta densidad permiten que los conectores con patillas en disposición abierta admitan señalización diferencial o con terminación sencilla digital, analógica y de alimentación. Estos conectores con matriz de alta densidad son idóneos en aplicaciones digitales y de alimentación de alta velocidad y alto rendimiento; ahora su estructura diferencial de conexión a tierra se puede utilizar con SOC de RF y aplicaciones como redes inalámbricas 5G, PHY/MSO remotos, radares de matriz en fase, prueba y medida, y satélites LEO/MEO.

El rendimiento corresponde a:

• Un ancho de banda de 8 GHz

• Una impedancia del sistema de 50 ohm para terminación sencilla y 100 ohm para diferencial

• Pérdida de retorno de -12 dB hasta 4 GHz; -10 dB hasta 8 GHz;

• Aislamiento de diafonía entre canales: -69 dBc a 4 GHz, -63 dBc a 8 GHz

El [diseño de referencia](https://suddendocs.samtec.com/testreports/20230809_t-3585732_aoac_seam-035_seaf-065_10mm_rev3.pdf) incluye la asignación de patillas recomendada dentro del informe completo de caracterización. Se están desarrollando otros diseños de referencia para aplicaciones de hasta 40 GHz. Para más información sobre selección de materiales para placas de circuito impreso, apilamiento y optimización de diseños, envíe un correo electrónico a [sig@samtec.com](mailto:sig@samtec.com).

Samtec, fundada en 1976, es un fabricante de una amplia línea de soluciones de interconexión electrónica como conexiones de alta velocidad entre placas, cables de alta velocidad, interconexiones ópticas para placas intermedias y paneles, RF de precisión, apilamiento flexible, y componentes y cables micro/robustos. Los centros tecnológicos de Samtec trabajan en el desarrollo de tecnologías, estrategias y productos para optimizar el rendimiento y el coste de un sistema, desde semiconductores sin encapsular hasta una interfase situada a 100 metros, y con todos los puntos de interconexión situados entre medio.

A close-up of several electronic components

Description automatically generated